

廣閱科 6693 法說會 QA 重點整理 (2026/8/21)

- **Q1：AI 伺服器馬達驅動晶片的技術與商業護城河為何？**
 - **A1：**AI 伺服器散熱系統正朝 48V 系統發展。廣閱的優勢在於能提供結合 MCU (如 i639X) 與 MOSFET 的整套驅動方案 (套片)，客戶馬達一來即可直接調校，大幅縮短開發時間。此外，公司擁有累積十多年的控制與噪音控制技術，且是國內較早具有 48V 系統量產經驗的供應商。
- **Q2：晶圓代工產能吃緊，公司如何確保產能？**
 - **A2：**台積電等先進製程晶片大量產出帶動了龐大的供電需求 (功率元件)。然而，國內外晶圓代工廠的功率元件產能極滿。廣閱正與晶圓廠洽談長期合約 (LTA) 以確保未來三年產能，並計劃將非先進製程的產品移往中國生產，釋出台灣產能給高階需求。
- **Q3：伺服器相關營收 (佔比 47%) 的內部結構為何？**
 - **A3：**BBU 約占 6-8%，電源相關應用佔比最高。公司看好下半年及明年，BBU 因備援功率提升，將迎來更大成長。
- **Q4：毛利率大幅提升的原因為何？未來能否維持？**
 - **A4：**過去毛利率常態在 25-30% 之間 (先前曾出現的 37% 為庫存迴轉所致，並非常態)。今年上半年晶圓代工成本上漲約 20%，公司審慎評估競爭與客戶承受度後，毛利率回升至 32%。面對下半年至明年封裝及晶圓可能再有一波漲幅，公司目標維持毛利率不低於現有水準。
- **Q5：封裝產能緊張，公司如何保障產能？**
 - **A5：**目前功率元件與模擬 IC 的封裝產能多集中於中國，因外商將非車用產能移往中國而產生排擠，使產能非常緊張。廣閱除了維繫深厚合作關係，此次發行可轉債 (CB) 的部分資金也將用於參與供應商的資本投資，以取得產能保證。
- **Q6：目前的存貨結構如何？生產週期有何變化？**
 - **A6：**目前約 4 億元的存貨多數為在製品 (WIP)。因單月營收已達 2 億元以上，存貨周轉天數持續下降，呈現一進一出的緊張狀態。由於晶圓投產與封裝排隊時間拉長，為目前營運主要挑戰。
- **Q7：與大股東 (茂迪、達爾) 是否有業務上的具體合作？**
 - **A7：**兩者皆為歷史悠久且友好的投資人股東 (茂迪持股約 16-17%，達爾為因併購敦南科技而繼承股權)，目前並無具體的專案或業務合作。
- **Q8：碳化矽 (SiC) 產品進展如何？**
 - **A8：**已推出 650V 及 1200V (15mΩ-18mΩ) 的 SiC 產品。雖然目前尚未貢獻營收，但受惠於 AI 電源 (HVDC) 的需求成長強勁，客戶導入需求提升。
- **Q9：下半年及明年營收展望如何？**
 - **A9：**下半年因單月營收站穩 2 億元以上，營收與獲利肯定優於上半年，全年獲利表現看好。明年目標維持雙位數以上的營收增長，動能來自產能的調配增加，以及價格提升。